

# 聚辰半导体股份有限公司

## 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 主板上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》以及《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等议案。现就有关公司筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的情况提示如下：

为推动公司全球化战略深入实施，面向国际资本市场拓宽融资渠道，构建多元化资本运作平台，持续增强资本实力和综合竞争力，加速海外业务拓展，完善境内外协同发展格局，进一步夯实并提升公司在行业中的领先地位，公司计划在境外发行境外上市外资股（H 股），并申请于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次 H 股上市”）。

公司将充分考虑现有全体股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）内选择适当的时机和发行窗口完成本次 H 股上市。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定等法律、法规和规范性文件的要求，本次 H 股上市尚需提交公司股东会审议，并须在符合中国境内及中国香港相关法

律、法规和规范性文件规定的要求和条件下推进，同时公司还需就本次 H 股上市取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所等相关监管机构、自律组织的备案、批准和/或核准。

截至本公告披露之日，公司正积极推进本次 H 股上市的相关工作，除公司第三届董事会第十次会议审议通过的相关议案外，其他关于本次 H 股上市的具体细节尚未最终确定。

本次 H 股上市能否通过备案、批准和/或核准程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次 H 股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日